

XC2VP40-6FFG1152I

Dalies numeris	XC2VP40-6FFG1152I	RoHs statusas	
Gamintojas / Gamintojas	AMD Xilinx	Akcijų būklė	5888 pcs stock
Prekės aprašymas	IC FPGA 692 I/O 1152FCBGA	Laivas iš	Hong Kong
Duomenų lapai	Virtex-II Pro, Pro X.pdf	Siuntimo būdas	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Gaukite citatą

Spustelėkite „Gaukite citatą“ ir užpildykite visus reikalingus laukus. Mes atsakysime į jūsų prašymą per 24 valandas el. Paštu. Jei susiduriate su kokiais nors klausimais, palikite pranešimą arba el. Paštu info@global-ic.hk, ir mes kuo greičiau susisieksime su jumis.

GAUKITE CITATĄ

XC2VP40-6FFG1152I specifikacijos

Įtampa - tiekimas	1.425V ~ 1.575V	Bendras RAM bitai	3538944
Tiekėjo prietaisų paketas	1152-FCBGA (35x35)	Serija	Virtex®-II Pro
Paketas / dėžutė	1152-BBGA, FCBGA	Paketas	Tray
Darbinė temperatūra	-40°C ~ 100°C (TJ)	Loginių elementų / elementų skaičius	43632
LAB / CLB skaičius	4848	I / O skaičius	692
Montavimo tipas	Surface Mount	Bazinis produkto numeris	XC2VP40

Susijusios naujienos



Vaizdo taškas: Laidų griovimas, kad būtų galima numesti svarus automobiliuose

2023/08/29

Remiamas turinys: Calterah, pirmaujanti Kinijos „MMWave IC“ teikėja

2023/09/11

„Reram Progress“ ataskaita

2023/04/26

Automobilių salės dabartinis jutiklis per visą gyvenimą yra 1% ir apima MCU

2023/09/12

IC supjaustoma dabartine impuls

2023/07/11

„Accellera“ nustato daugialypės srities modeliavimo diskusijų datą

2023/08/22

Valdomi ar nevaldomi pramoniniai eterneito jungikliai

2023/08/21

Patikrinimo kameros išmatuoja iki 800 nm gamybos

2023/08/11

Londono elektrinių sunkvežimių gamintojas, skirtas susijungti su Arizonos EV sutarčių gamintoju

2023/08/15

BLE garso ir jo vieta „Bluetooth“ evoliucijoje

2023/07/19

„Viewpoint“: „Lorawan“, naudojant „Lorawan“

2023/07/14

„Sony“ siekia fotoaparato dronams ir robotams pramonės vartotojams

2023/09/6